

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-048

方正科技集团股份有限公司

关于投资建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地 HDI 项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●项目名称：方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）投资建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地二期高阶 HDI 项目（以下简称“二期高阶 HDI 项目”或“本项目”）；

●投资金额：本项目预计投资 6.896 亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准）；

●特别风险提示：本项目实施建设进程存在不确定性；项目建成后存在因市场订单不及预期以及产品良率达不到预期从而导致本项目投资效益达不到预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、本项目概述

1、本项目的基本情况

公司第十一届董事会 2018 年第三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目的议案》，同意珠海多层于珠海市斗门区富山工业园新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目（以下简称“F7 工厂”），项目预计总投资为 9.9959 亿元人民币；2020 年 7 月，公司根据市场需求变化和效益最大化目的，对新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目增加投资，项目预计总投资增加为 16.89 亿元人民币，该增加投资事项已经公司第十二届董事会 2020 年第五次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

受北大方正集团有限公司以及公司重整因素影响，F7 工厂项目投资进度整体滞后，截至 2023 年 6 月 14 日，项目实际共投入资金约 11.47 亿元，占总体投资完成率 67.88%。F7 工厂项目一期规划产品定位为高多层 PCB，聚焦 5G 通讯基站及配套的周边应用领域，2021 年 7 月正式投产，在产品市场开发及订单承接方面取得了一定的成果。自 2022 年下半年开始，PCB 产品市场通讯基站类需求出现一定幅度的下滑，且从当前通讯技术的发展趋势看，未来短时间内难以出现规模性的增长。伴随着市场竞争的加剧，高多层 PCB 产品单价持续下降，对 F7 工厂的中长期可持续发展将构成经营风险，因此，F7 工厂二期需要调整整体规划以扭转经营局面。

公司全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）已搭建完善的 HDI 客户梯队与多样化产品线，现有客户订单已超出其承接能力、在手 HDI 订单明确，且从中长期市场发展趋势看，消费电子及车载产品市场需求稳定，未来可持续发展基础良好，为公司 HDI 的产能规模扩张提供可靠的订单基础。根据公司 PCB 经营计划，为进一步扩大公司 PCB 在全球高端 HDI 产品市场的核心竞争力，优化 PCB 整体业务布局，满足公司 PCB 现有 HDI 客户的订单产能需求和高阶产品技术迭代的需要，公司全资子公司珠海多层拟投资建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地二期高阶 HDI 项目，通过利用 F7 工厂现有厂房空间，快速承接珠海高密高阶 HDI 溢出客户和产品订单，并通过构建专业的 HDI 产品线，打造 F7 工厂高阶 HDI 产品的全流程自制能力，独立承接 HDI 客户批量订单任务，与珠海高密一起深耕 HDI 细分产品领域。二期高阶 HDI 项目

规划设计产能为月产 11.5 万平方英尺，预计投资为 6.896 亿元人民币，项目资金自筹。

2、董事会审议情况

公司于 2023 年 6 月 14 日召开第十三届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于投资建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地 HDI 项目的议案》，公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人员审批本项目具体方案。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、本项目对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、本项目的具体情况

1、实施主体

公司名称：珠海方正科技多层电路板有限公司，为公司全资子公司。

统一社会信用代码：914404006174901500

注册地点：珠海市

注册资本：14,400.54 万美元

法定代表人：张扬

经营范围：生产和销售（包括零售、批发）自产的多层印刷电路板、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印制电路板、柔性线路板，开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品，提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、实施地点：珠海市斗门区富山工业园内。

3、产品及产能：高阶 HDI，规划设计产能为月产 11.5 万平方英尺。

4、建设内容：本项目是在 F7 工厂现有厂房的基础上，通过优化现有厂房与车间布局，在 F7 工厂内规划高阶 HDI 产品线，使 F7 工厂具备高阶 HDI 产品技术能力并提升整体产能规模。

5、实施周期：本项目实施周期为 12 个月，最终以实际建设情况为准。

6、总投资额及资金来源：本项目预计投资 6.896 亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为自筹。

三、投资本项目对公司的影响

投资建设本项目是公司实现中长期目标的重要举措，有利于进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，符合公司战略发展规划。通过最大化利用公司 F7 工厂现有生产线及厂房基础，将提高公司 PCB 高阶 HDI 的技术能力和产能规模，进一步提升公司 PCB 在全球高端 HDI 产品市场的核心竞争力，为公司 PCB 实施市场布局与产品线规划、储备高阶 HDI 订单及维持现有客户群等创造有利条件

本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、项目的风险提示

1、本项目实施进程存在不确定性，存在因政策法规、政府审批、市场需求、技术研发、工程进度、工程质量、资金供应而导致无法按照项目实施计划完成的风险。

2、本项目实施投产后，F7工厂将增加11.5万平方英尺/月的高阶HDI产能，从公司PCB现有HDI客户群的需求及在现有HDI客户的订单份额来看，当前的HDI订单储备量具备支撑本项目投产后的产能需求，但在实际生产运营过程中，消费类HDI可能出现季节性的订单波动，影响整体产能利用率。同时，如果出现HDI市场不可预见的变化情况，造成HDI整体市场需求下滑，或某个大客户重大项目

调整，或现有客户未来市场订单增量不及预期，也可能影响公司HDI的整体产能利用率，导致本项目投产后投资效益达不到预期的风险。

3、本项目实施后，F7厂房内将同时存在高多层PCB产品线和HDI产品线，形成两类产品线共线生产与品质管理的局面，对全流程品质控制、自动化对接和信息化管理的实现具有较大的难度，进一步增加实际品质良率提升达不到预期的风险。

五、公司采取的风险控制措施

为保障本项目实施建设顺利完成，公司将制定严密的进度总控制计划，加强本项目实施过程中的工程管理和财务管理，合理安排工期，通过组织、管理、技术等措施对各项目进度进行全程控制。此外，公司将根据HDI产能上量节奏，提前实施市场策略，完善梯级客户群，通过充分利用珠海高密和F7工厂的联合产能优势，提升客户大项目参与度和接单份额。公司还将通过搭建核心管理团队、优先支援关键人员、持续优化加工工艺参数等措施，持续提升本项目产品品质良率。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023年6月15日